

関係各位

AEC/APC Symposium Asia 2023 Executive Committee Chair
ルネサス エレクトロニクス株式会社
情報システム統括部 製品開発支援システム部 部長
西村 英孝

AEC/APC Symposium Asia 2023 Program Committee Chair
キオクシア株式会社
メモリ技術研究所 デジタルトランスフォーメーション技術研究開発センター
アルゴリズム技術開発部 主幹
柿沼 英則

AEC/APC Symposium Asia 2023 スポンサーシップ・出展のお願い

拝啓 ますますご盛栄の段、心よりお慶び申し上げます。

この度、日本開催の第9回目となる AEC/APC Symposium Asia 2023 を 2023 年 11 月 2 日に開催する運びとなりました。本年は開催形態を会場開催とオンライン併用のハイブリットにて開催の予定です。

AEC/APC Symposium は、1989 年以降、米国、欧州、アジアにて開催、日本では皆様のご支援を賜り、2007 年以降、奇数年に 8 回開催の実績を上げることができ、半導体製造におけるデータドリブンな AEC/APC を中心に、最先端の半導体生産技術を議論する重要な国際シンポジウムとしての位置づけを確立することができました。

本シンポジウムは半導体製造工程制御領域のエキスパートが世界中から集まる国際会議であり、半導体生産の要となる技術情報の発信地・ネットワークキングの場として重要性を増しております。

2007 年に開催された第一回 AEC/APC Symposium Japan 大会では、2 日に亘るプログラムに予想を大きく上回る 8 カ国 435 名様のお聴講を賜り、以降、2009 年、2011 年、2013 年、2015 年、2017 年、2019 年と 200 名を超える方々のご参加を頂きました。2021 年には感染症の影響により初めてのオンラインでの開催となりましたが 300 名を超えるご参加をいただきました。

また、スポンサーシップ（ご協賛）も第 1 回の 2007 年から多くの皆様のご堅調なご支持を頂いております。

AEC/APC Symposium Asia 2023 は「複雑さをひも解くデータ活用のベストプラクティス」をテーマに、デバイスメーカーの前工程はもとより、後工程及びコンテンツに深く関わっているデバイスメーカー、装置メーカー、ソフトウェアベンダ、センサー・メトロロジサプライヤなどで従事される多くの皆様のご参加を募る予定です。

つきましては、AEC/APC Symposium Asia 2023 におきまして、何卒、貴社のスポンサーシップ（ご協賛）ならびにご出展を賜りたく、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

わが国の半導体産業の基盤強化、国際協調の推進等の一助とお考え頂き、ご協力をお願い致します。

敬具

AECAPC Symposium Asia 2023 事務局
株式会社セミコンダクタポータル
aecapc_2023@semiconportal.com

AEC/APC Symposium Asia 2023 開催概要

1. 開催月日： 2023年11月2日（木）
2. 開催形態： ハイブリッド開催（会場参加メイン）
3. 主催： AEC/APC Asia 2023 日本委員会
4. 協賛： 一般社団法人 日本半導体製造装置協会（SEAJ）
一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）（予定）
SEMI ジャパン
後援： 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会
関連学会： International Symposium on Dry Process（DPS）
5. 参加人数： 200名（予定）

AEC/APC Symposium Asia 2023 スポンサーの特典

お申込みは下記 URL からお願いします

<https://jp.surveymonkey.com/r/aaa2023SponsorExhibitorJ>

	Platinum プラチナ スポンサー	Gold ゴールド スポンサー	Silver シルバー スポンサー	Bronze ブロンズ スポンサー
Sponsorship Fee スポンサー額 (税込)	¥800,000	¥500,000	¥300,000	¥80,000
AEC/APC Symposium Asia Invitation (Free) AEC/APC Symposium Asia への招待枠				
Free ticket(s) for AEC/APC Symposium Asia (Tutorial session excluded) AEC/APC Symposium Asia へのご招待人数 ※ 御社外のお客様へのご招待へご利用いただいても結構です。	12	7	4	1
AEC/APC Symposium Asia Website AEC/APC Symposium Asia ウェブサイト				
Company logo placed on the website ホームページでのスポンサーカンパニーロゴの記載	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Link to company homepage スポンサーカンパニーホームページへのリンク	Yes 有	Yes 有	Yes 有	Yes 有
AEC/APC Symposium Asia Proceedings (Download) & Brochure AEC/APC Symposium Asia 予稿集(ダウンロード資料)、当日配布資料				
Recognition of sponsorship in meeting materials along with company logo and link to corporate website (User would need to have Internet access when viewing the proceedings) 会議資料におけるスポンサーカンパニーロゴの表示とスポンサーカンパニーホームページへのリンク(視聴の際に要インターネット接続)	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Company logo printed in color on the brochure on site 当日配布されるハンドアウト(または APP)上にスポンサーカンパニーロゴをカラー表示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
AEC/APC Symposium Asia Screen at site AEC/APC Symposium Asia 会場のご広告				
Company logo on the screen of interval スクリーン上にスポンサーカンパニーロゴを表示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Company logo poster at the Symposium Room 会場にスポンサーカンパニーロゴポスターを掲示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
その他 リスト提供				
参加者リスト (提供に同意された方のみ) ※ご提供するリスト情報内容 (氏名、所属機関名、メールアドレス)	○	○	×	×

★AEC/APC Symposium Asia 出展

スポンサーシップと出展の場合 (1 小間) (税込み)	¥100,000
出展のみの場合 (1 小間) (税込み)	¥120,000

<お得な協賛・出展価格>

スポンサーシップと出展両方の場合には割引価格で出展頂けます

運営委員会

委員長	西村 英孝	ルネサス エレクトロニクス株式会社 情報システム統括部 製品開発支援システム部 部長
-----	-------	---

プログラム委員会

委員長	柿沼 英則	キオクシア株式会社 メモリ技術研究所 デジタルトランスフォーメーション技術研究開発センター アルゴリズム技術開発部 主幹
-----	-------	---

副委員長	有馬 澄佳	筑波大学 システム情報系 社会工学域 講師
------	-------	-----------------------

委員	黒澤 敬	アズビル株式会社 AAC SS マーケティング部商品企画グループ (兼務) 技術開発本部センシングデバイス技術部 マネージャー
	千崎 昌彦	アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニー CP マーケティング部 商品企画グループ 課長代理
	土山 洋史	インフィコン株式会社 インテリジェントマニュファクチャリングシステムズ スマートマニュファクチャリング ディレクタ
	西部 泉一	ケーエルイー・テンコール株式会社 パターンニング製品技術部 リソグラフィアー テクニカルエキスパート
	平井 都志也	株式会社 KOKUSAI ELECTRIC DX 推進室 主管技師長
	澁木 俊一	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 技術推進室 統括部長
	坂本 浩一	東京エレクトロン株式会社 FSBU フィールドソリューション部ソリューションプランニング グループ グループリーダー
	田中 尚人	東京エレクトロン株式会社 PF 開発部 エキスパート
	長嶋 一高	東芝デバイス&ストレージ株式会社 半導体事業部 先端半導体デバイス開発センター 先端半導体デバイス第一開発部 データ解析技術開発グループ マネジャー
	大石 修	日本アイ・ピー・エム デジタルサービス株式会社 デジタル事業部 インダストリアルソリューション技術統括部 シニア・アーキテクト 担当部長
	堀本 耕	日本アイ・ピー・エム デジタルサービス株式会社 デジタル事業部 インダストリアルソリューション本部 第三 MES ソリューション部 部長 シニア・アーキテクト
	田中 知哉	タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社 プロセステクノロジーセンタープロセス技術開発部 イールドマネジメント開発課 課長
	三宅 賢治	オフィス三宅 代表、先端半導体パッケージアナリスト
	鹿子嶋 昭	株式会社 日立ハイテック 電子デバイスシステム事業統括本部 笠戸地区設計生産本部 プロセス研究開発部 量産開発グループ 主任技師
	槌谷 孝裕	ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 設備技術部 プロフェッショナルエンジニア
宮武 剛	ルネサスエレクトロニクス株式会社 生産本部/前工程生産技術統括部/プロセス装置技術部/生産性改善・予知保全課	

事務局：(株)セミコンダクタポータル

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-4 アーバン虎ノ門ビル 6F Tel: 03-6807-3970

aecapc_2023@semiconportal.com